

3.1 以产线牵引集成电路全链条突破

服务国家战略,加快推进集成电路关键核心零部件、材料、关键装备等攻关,打造技术创新与产业发展新高地。



重大原创成果竞相涌现

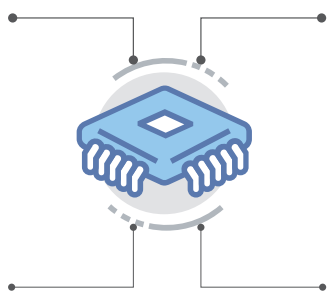
芯片研发

全球首个基于二维半导体材料的32位RISC-V架构微处理器“无极(WUJI)”发布,在国际上实现二维逻辑芯片最大规模验证纪录

全球首个二维-硅基混合架构芯片成功研制,攻克新型二维信息器件工程化的关键难题

新一代算力芯片领域取得重大突破,首次实现支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片

集成泵浦滤波与单光子探测功能的纠缠接收芯片成功研制,完成低温光量子芯片间的纠缠分发应用演示



器件制备

开发纳米限制结构相变存储器,实现可量产相变存储器千亿次擦写寿命验证

研制量子电流传感器,满足±800kV特高压输电线路的挂网应用需求

研制出光子数可分辨的超高速光量子探测器,支撑光量子计算、量子通信等前沿领域的实用化突破

研制超导双光子空间符合计数器,支撑光量子计算的多空间态符合探测

3.2 以创新药械带动生物医药高质量发展

加快落实生物医药全链条创新发展意见,坚持“研发+临床+制造+应用”全产业链体系化推进,紧抓创新药大IP品种培育,加快高端医疗器械领域发展,强化药械监管制度改革与国际开放创新,全力建设全球生物医药创新高地和世界级产业集群。